

野村世界業種別投資シリーズ (世界半導体株投資)

運用報告書(全体版)

第17期（決算日2026年6月29日）

作成対象期間（2025年7月1日～2026年6月29日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／株式
信託期間	2009年8月27日以降、無期限とします。
運用方針	世界各国の半導体関連企業の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。株式への投資にあたっては、定量分析により銘柄群の絞込みを行なった後、トップダウン・アプローチによる各国・地域のマクロ投資環境見通しを考慮しつつ、技術力、価格決定力、利益構造、財務内容などの観点からファンダメンタルズ分析を行ない、組入銘柄を決定します。また、個別銘柄評価とポートフォリオ全体のリスク特性などを総合的に勘案し、ポートフォリオを構築します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
主な投資対象	世界各国の半導体関連企業の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

●サポートダイヤル

0120-753104（受付時間）営業日の午前9時～午後5時

●ホームページ

<https://www.nomura-am.co.jp/>

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額		ベンチマーク		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
		税 分	込 配 金	期 騰 落	中 率			
	円		円		%	%	%	百万円
13期(2022年 6 月28日)	60,702		2,650		1.6	2.3	97.6	33,153
14期(2023年 6 月28日)	91,149		4,350		57.3	51.1	98.7	73,864
15期(2024年 6 月28日)	175,535		9,000		102.5	106.6	98.6	419,208
16期(2025年 6 月30日)	172,246		8,000		2.7	5.6	98.7	424,584
17期(2026年 6 月29日)	347,429		18,000		112.2	116.1	98.5	941,830

* 基準価額の騰落率は分配金込み。
* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

* ベンチマーク（＝MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment（税引後配当込み・円換算ベース））は、MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment（税引後配当込み・ドルベース）をもとに、当社が独自に円換算したものです。
* MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment（税引後配当込み・ドルベース）は、MSCIが開発した指数で、同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
(出所) MSCI、ブルームバーグ

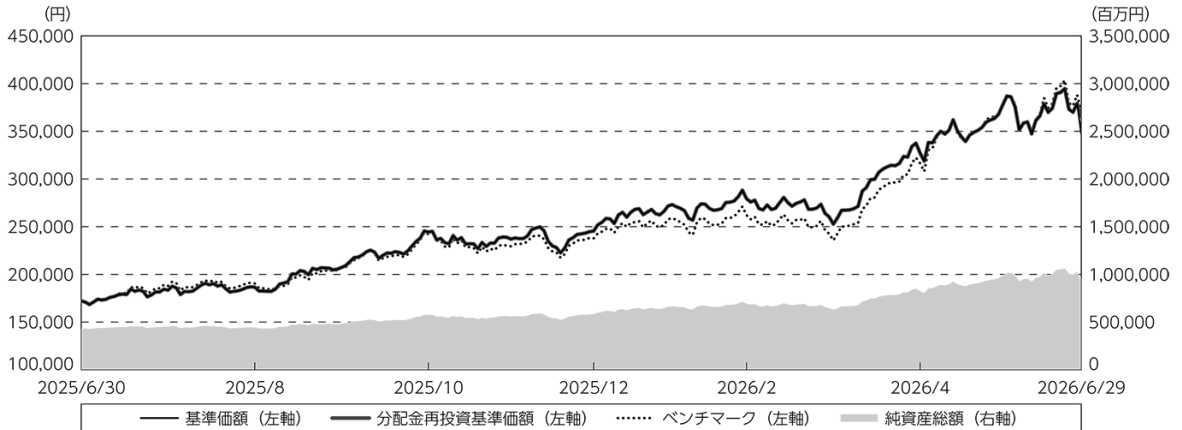
○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額		ベンチマーク		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
		騰 落	率	騰 落	率		
(期 首)	円		%		%	%	%
2025年 6 月30日	172,246		－		－	98.7	－
7 月末	187,642		8.9		11.6	99.2	－
8 月末	186,707		8.4		10.6	99.3	－
9 月末	205,547		19.3		18.8	98.9	－
10月末	244,417		41.9		40.6	99.2	－
11月末	239,095		38.8		34.2	98.8	－
12月末	245,403		42.5		38.0	99.2	－
2026年 1 月末	273,104		58.6		50.3	99.2	－
2 月末	279,336		62.2		52.1	99.2	－
3 月末	252,735		46.7		36.8	99.3	－
4 月末	327,124		89.9		83.7	99.1	－
5 月末	363,359		111.0		112.4	98.8	－
(期 末)							
2026年 6 月29日	365,429		112.2		116.1	98.5	－

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：172,246円

期 末：347,429円（既払分配金（税込み）：18,000円）

騰落率： 112.2%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作定期首（2025年6月30日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment（税引後配当込み・円換算ベース）です。ベンチマークは、作定期首（2025年6月30日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

（上昇要因）

- ・ 米国の日本やEU（欧州連合）との貿易交渉合意が好感されたこと
- ・ FRB（米連邦準備制度理事会）が利下げを実施したこと
- ・ 大手半導体企業とAI関連企業によるAIインフラ構築に関する契約締結が好感されたこと
- ・ 米国とイランが2週間の停戦合意を発表し、ホルムズ海峡の開放期待が高まったこと
- ・ 半導体関連企業の堅調な業績動向への期待が高まったこと

（下落要因）

- ・ 高値警戒感から大手半導体企業の決算を前にハイテク関連銘柄が下落したこと
- ・ AIにより企業の既存業務が代替されるとの懸念からソフトウェア関連株などが下落したこと
- ・ 中東情勢の緊迫化が嫌気されたこと、エネルギー価格の上昇などを受けたインフレ率の高止まりが警戒されたこと

○投資環境

当期の世界の半導体・半導体製造装置株は、2025年7月に米国の日本やEUとの貿易交渉合意が好感されたこと、9月にFRBが利下げを実施したことや、大手半導体企業とAI関連企業によるAIインフラ構築に関する契約締結が好感されたことなどを背景に上昇して始まりました。11月には、高値警戒感から米大手半導体企業の決算を前にハイテク関連銘柄を中心に下落する場面もありましたが、その後は11月の米CPI（消費者物価指数）上昇率の鈍化などを受けて2026年の追加利下げへの期待が高まったことや、大手半導体企業が市場予想を上回る決算を発表したことなどから、再び上昇基調で推移しました。2026年2月上旬には、AIにより企業の既存業務が代替されるとの懸念からソフトウェア関連株などを中心に下落し、3月には米国とイランの軍事衝突による中東情勢の緊迫化が嫌気されたことや、エネルギー価格の上昇などを受けてインフレ率の高止まりが警戒されたことなどから下落しました。しかし、4月以降は米国とイランが2週間の停戦合意を発表し、ホルムズ海峡の開放期待が高まったことや、半導体関連企業の堅調な業績動向への期待が高まったことなどを背景に反発し、当期において世界の半導体・半導体製造装置株は上昇となりました。

為替市場については、米ドルに対して円安となりました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

期を通じておおむね高位を維持しました。

・期中の主な動き

- （１）地域・国別配分では、台湾やオランダをオーバーウェイト（ベンチマークに比べ高めの投資比率）としました。一方、米国、日本などをアンダーウェイト（ベンチマークに比べ低めの投資比率）、フランス、中国などを非保有としました。
- （２）個別銘柄では、エヌビディア（米国）、ブロードコム（米国）、台湾セミコンダクター（台湾）などを上位に組み入れました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

ベンチマーク（MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment（税引後配当込み・円換算ベース））が116.1%の上昇となったのに対して、基準価額は112.2%の上昇となりました。

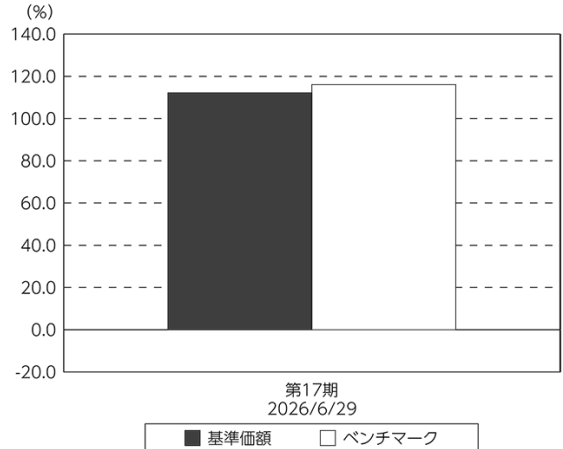
（主なプラス要因）

- ①地域・国別配分で、株価騰落率がベンチマークを上回った台湾などをオーバーウェイトとしたこと
- ②個別銘柄において、株価騰落率がベンチマークを上回ったマイクロン・テクノロジー（米国）などをオーバーウェイトとしたこと

（主なマイナス要因）

- ①地域・国別配分で、株価騰落率がベンチマークを上回った日本をアンダーウェイトとしたこと
- ②個別銘柄において、株価騰落率がベンチマークを上回ったアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（米国）などをアンダーウェイトとしたこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。

（注）ベンチマークは、MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment（税引後配当込み・円換算ベース）です。

◎分配金

収益分配金は、当ファンドの分配方針に基づき、次表の通りとさせていただきます。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第17期
	2025年7月1日～ 2026年6月29日
当期分配金 (対基準価額比率)	18,000 4.926%
当期の収益	18,000
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	337,428

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

・投資環境

- (1) 米国経済は、底堅い動きが続いています。5月のCPIは前年同月比+4.2%となり、4月（同+3.8%）より伸び率が高まりました。一方で、5月の家計実質可処分所得は前月比+0.3%と増加に転じ、同月の実質個人消費も+0.3%と底堅く推移しています。5月の非農業部門雇用者数も前月差+17.2万人となり、雇用も堅調です。6月のFOMC（米連邦公開市場委員会）では、政策金利の据え置きが決定されました。米国とイランの終戦合意を受けた原油価格下落などを受けて物価や景気への悪影響は今後和らいでいくとみえますが、FOMCは物価上昇への警戒感を強めつつあり、引き続き景気や金融政策の動向には注視が必要と考えています。
- (2) 欧州経済は、中東情勢の緊張緩和期待が高まったことから、足元ではエネルギー価格の下落が見られるものの、今後の物価上昇への予防的な措置としてECB（欧州中央銀行）が6月に利上げを行なうなど、依然として不透明な状況が続いています。6月のユーロ圏総合PMI（購買担当者景気指数）速報値は49.5、同月のユーロ圏サービス業PMI速報値は48.9となり、前月数値、市場予想をともに上回ったものの、景気判断の基準となる50を3ヵ月連続で下回りました。また、6月のユーロ圏製造業PMI速報値は51.3と前月数値、市場予想をともに下回りました。引き続き物価や金融政策の動向には注視が必要と考えています。

・投資方針

- (1) 当ファンドはボトムアップアプローチを重視し、技術力、価格決定力、利益構造、財務内容などの観点から、グローバルに半導体・半導体製造装置市場をリードしていくことができる企業群に投資します。ファンドのポートフォリオ構築にあたっては、地域・国別配分、業種別配分ともに市場の時価総額構成比を意識した配分を行ない、世界の半導体関連株市場全体の動きを反映したリターンの獲得を目指します。
- (2) 銘柄選択においては、中長期での成長が見込まれる分野として、AI半導体や、通信（インフラ）用半導体、メモリー半導体、先進運転システム向け半導体などが有望と考えています。また、AI機能を搭載した自動車やロボットなどに使われる低消費電力かつ高性能な半導体や、人工衛星などに使われる宇宙など過酷な環境にも対応した半導体にも注目しています。足元でAIインフラ投資は研究開発段階である学習向けから企業業績に貢献する活用向けへと移行しており、広がりを見せています。これら需要先の動向が半導体各社の業績に与える影響を考慮しながら銘柄選択を行ないます。
- (3) 当面の運用方針としては、収益性や競争力の高い銘柄を中心に、今後の成長力とバリュエーション（投資価値評価）のバランスに配慮したポートフォリオ構築を行なう方針です。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025 年 7 月 1 日～2026 年 6 月29日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 4,082	% 1.645	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(1,946)	(0.784)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
(販 売 会 社)	(1,946)	(0.784)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(190)	(0.077)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	158	0.064	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(158)	(0.064)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	104	0.042	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(104)	(0.042)	
(d) そ の 他 費 用	57	0.023	(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(49)	(0.020)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(8)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	4,401	1.774	
期中の平均基準価額は、248,059円です。			

* 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

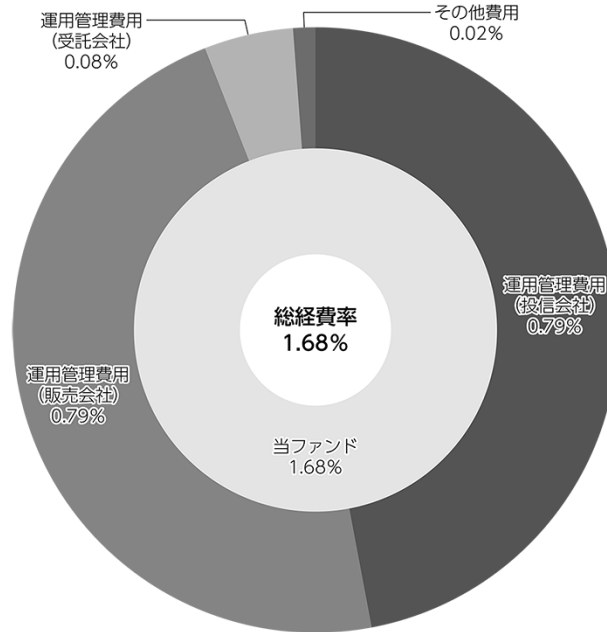
* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.68%です。



(注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2025年7月1日～2026年6月29日)

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	アメリカ	百株 70,797 (6,947)	千米ドル 1,933,390 (—)	百株 48,758	千米ドル 1,466,604
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	8,201	53,411	—	—
	オランダ	580	45,226	826	64,166
	韓国	1,770	千ウォン 116,595,485	2,493	千ウォン 137,561,138
	台湾	25,720	千新台幣ドル 4,957,514	59,390	千新台幣ドル 14,628,374

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

○株式売買比率

(2025年7月1日～2026年6月29日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	690,028,241千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	618,415,402千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.11

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2025年7月1日～2026年6月29日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2026年6月29日現在)

国内株式

銘柄		期首(前期末)	当 期 末	
		株 数	株 数	評 価 額
電気機器 (100.0%)		千株	千株	千円
東京エレクトロン		3.7	3.7	276,390
合 計	株 数 ・ 金 額	3.7	3.7	276,390
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	<0.0%>

*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。

*銘柄欄の（ ）内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

*評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

外国株式

銘		柄		期首(前期末)	当		期		末		業	種	等			
				株	数	株	数	評		価				額		
								外貨建金額	邦貨換算金額							
(アメリカ)				百株		百株		千米ドル		千円						
ADVANCED MICRO DEVICES				204		14		742		120,143			半導体・半導体製造装置			
ANALOG DEVICES INC				32		32		1,242		201,028			半導体・半導体製造装置			
APPLIED MATERIALS				16		6,099		382,333		61,846,272			半導体・半導体製造装置			
ASTERA LABS INC				—		5,133		201,096		32,529,385			半導体・半導体製造装置			
BROADCOM INC				22,005		21,441		782,668		126,604,411			半導体・半導体製造装置			
ENPHASE ENERGY INC				76		—		—		—			半導体・半導体製造装置			
INTEL CORP				381		381		4,895		791,839			半導体・半導体製造装置			
KLA CORP				1,158		7,450		185,248		29,965,795			半導体・半導体製造装置			
LAM RESEARCH CORP				77		77		2,929		473,831			半導体・半導体製造装置			
MARVELL TECHNOLOGY INC				43		43		1,156		187,110			半導体・半導体製造装置			
MICROCHIP TECHNOLOGY				214		214		1,883		304,597			半導体・半導体製造装置			
MICRON TECHNOLOGY				15,939		4,136		468,403		75,768,873			半導体・半導体製造装置			
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC				—		4		563		91,137			半導体・半導体製造装置			
NVIDIA CORP				61,090		79,637		1,533,268		248,021,479			半導体・半導体製造装置			
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION				105		105		959		155,140			半導体・半導体製造装置			
QUALCOMM INC				4,981		9,736		184,394		29,827,617			半導体・半導体製造装置			
TERADYNE INC				—		3,470		151,614		24,525,223			半導体・半導体製造装置			
TEXAS INSTRUMENTS INC				2,683		16		471		76,319			半導体・半導体製造装置			
NXP SEMICONDUCTORS NV				29		29		803		129,951			半導体・半導体製造装置			
小		計		株数・金額	109,038	138,024		3,904,674		631,620,158						
				銘柄数<比率>	16	18		—		<67.1%>						
(ユーロ…ドイツ)								千ユーロ								
INFINEON TECHNOLOGIES AG				116		8,317		65,126		11,996,242			半導体・半導体製造装置			
小		計		株数・金額	116	8,317		65,126		11,996,242						
				銘柄数<比率>	1	1		—		<1.3%>						
(ユーロ…オランダ)																
ASM INTERNATIONAL NV				654		152		14,495		2,670,138			半導体・半導体製造装置			
ASML HOLDING NV				2,184		2,441		385,254		70,963,860			半導体・半導体製造装置			
小		計		株数・金額	2,839	2,594		399,750		73,633,999						
				銘柄数<比率>	2	2		—		<7.8%>						
ユ		ー		株数・金額	2,955	10,911		464,876		85,630,242						
				銘柄数<比率>	3	3		—		<9.1%>						
(韓国)								千ウォン								
SK HYNIX INC				2,191		1,468		392,431,149		41,242,944			半導体・半導体製造装置			
小		計		株数・金額	2,191	1,468		392,431,149		41,242,944						
				銘柄数<比率>	1	1		—		<4.4%>						
(台湾)								千新台幣ドル								
MEDIATEK INC				24,080		5,370		2,083,560		10,571,358			半導体・半導体製造装置			
TAIWAN SEMICONDUCTOR				129,940		114,580		26,811,720		136,034,623			半導体・半導体製造装置			
ASPEED TECHNOLOGY INC				2,420		2,820		4,403,430		22,341,682			半導体・半導体製造装置			
小		計		株数・金額	156,440	122,770		33,298,710		168,947,664						
				銘柄数<比率>	3	3		—		<17.9%>						
合		計		株数・金額	270,625	273,174		—		927,441,009						
				銘柄数<比率>	23	25		—		<98.5%>						

* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

* 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

○投資信託財産の構成

(2026年6月29日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 927,717,399	% 92.8
コール・ローン等、その他	72,063,564	7.2
投資信託財産総額	999,780,963	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建純資産（934,952,783千円）の投資信託財産総額（999,780,963千円）に対する比率は93.5%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=161.76円、1スイスフラン=199.70円、1ユーロ=184.20円、1ウォン=0.105096円、1新台幣ドル=5.0737円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2026年6月29日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	999,780,963,742
コール・ローン等	67,911,096,669
株式(評価額)	927,717,399,540
未収入金	3,568,362,647
未収配当金	582,354,732
未収利息	1,750,154
(B) 負債	57,950,267,403
未払収益分配金	48,795,464,451
未払解約金	2,876,512,077
未払信託報酬	6,267,563,820
その他未払費用	10,727,055
(C) 純資産総額(A－B)	941,830,696,339
元本	27,108,591,362
次期繰越損益金	914,722,104,977
(D) 受益権総口数	27,108,591,362口
1万口当たり基準価額(C/D)	347,429円

(注) 期首元本額は24,649,844,370円、期中追加設定元本額は11,097,367,510円、期中一部解約元本額は8,638,620,518円、1口当たり純資産額は34,7429円です。

(注) 投資信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用、支払金額2,486,792,113円。

○損益の状況（2025年7月1日～2026年6月29日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	3,490,110,994
受取配当金	3,389,764,069
受取利息	100,206,102
その他収益金	140,823
(B) 有価証券売買損益	429,217,950,355
売買益	479,050,762,620
売買損	△ 49,832,812,265
(C) 信託報酬等	△ 10,502,699,774
(D) 当期損益金(A+B+C)	422,205,361,575
(E) 前期繰越損益金	63,765,039,840
(F) 追加信託差損益金	477,547,168,013
(配当等相当額)	(184,401,092,793)
(売買損益相当額)	(293,146,075,220)
(G) 計(D+E+F)	963,517,569,428
(H) 収益分配金	△ 48,795,464,451
次期繰越損益金(G+H)	914,722,104,977
追加信託差損益金	477,547,168,013
(配当等相当額)	(184,401,092,793)
(売買損益相当額)	(293,146,075,220)
分配準備積立金	437,174,936,964

*損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

*損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

*損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

（注）分配金の計算過程（2025年7月1日～2026年6月29日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2025年7月1日～ 2026年6月29日
a. 配当等収益(経費控除後)	3,405,039,126円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	418,800,322,449円
c. 信託約款に定める収益調整金	477,547,168,013円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	63,765,039,840円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	963,517,569,428円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	355,428円
g. 分配金	48,795,464,451円
h. 分配金(1万口当たり)	18,000円

○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金（税込み）	18,000円
----------------	---------

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。
※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。
※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

「一般社団法人投資信託協会」と「一般社団法人日本投資顧問業協会」が2026年4月1日で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更されたことに伴い、投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に改める所要の約款変更を行ないました。
＜変更適用日：2026年4月1日＞